

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年8月15日(15.08.2024)

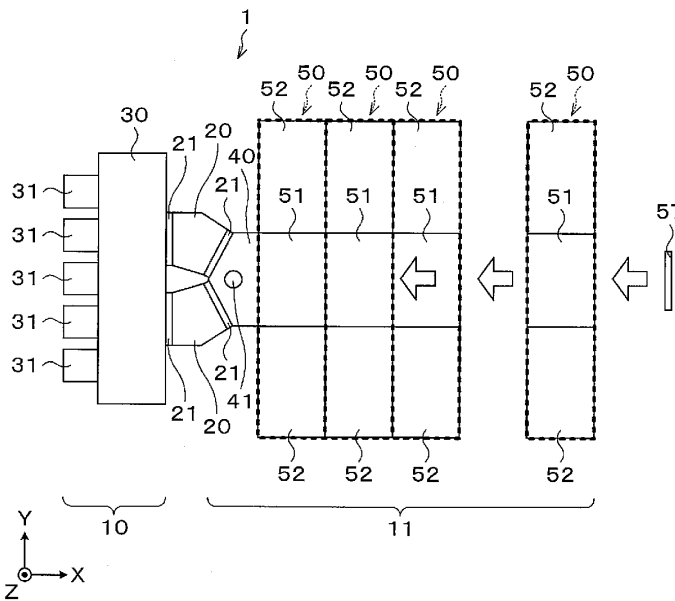


(10) 国際公開番号
WO 2024/166739 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/677 (2006.01) *H01L 21/205* (2006.01)
H01L 21/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/002792
- (22) 国際出願日: 2024年1月30日(30.01.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-018670 2023年2月9日(09.02.2023) JP
- (71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(**TOKYO ELECTRON LIMITED**) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 網倉 紀彦 (**AMIKURA, Norihiko**); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 永関 一也 (**NAGASEKI, Kazuya**); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP).
- (74) 代理人: 金本 哲男, 外(**KANEMOTO, Tetsuo et al.**); 〒1620065 東京都新宿区住吉町1-20 角張ビル 曙国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS

(54) 発明の名称: 基板処理装置



(57) Abstract: Disclosed is a substrate processing apparatus for processing a substrate, the substrate processing apparatus comprising a plurality of composite modules, each of which is obtained by integrating one conveyance chamber that is provided with a conveyance space for substrates and a process chamber that is provided with a processing space for substrates with each other, wherein the plurality of composite modules are joined with each other by connecting conveyance chambers adjacent to each other. The conveyance spaces of the connected conveyance chambers are in communication

[続葉有]

EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG,
KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,
LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

with each other. The conveyance spaces are maintained in a vacuum atmosphere.

(57) 要約: 基板を処理する基板処理装置であって、基板の搬送空間を備えた1つの搬送チャンバと、基板の処理空間を備えた処理チャンバとが一体化された複合モジュールを複数有し、隣接する前記搬送チャンバ同士が接続されて、複数の前記複合モジュールが連結される。接続された複数の前記搬送チャンバの搬送空間は連通する。前記搬送空間は真空雰囲気に維持される。